

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年2月29日(29.02.2024)



(10) 国際公開番号

WO 2024/042752 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/50 (2006.01) H01L 21/677 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2023/008553
- (22) 国際出願日: 2023年3月7日(07.03.2023)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2022-133804 2022年8月25日(25.08.2022) JP
- (71) 出願人: T O W A 株 式 会 社 (TOWA CORPORATION) [JP/JP]; 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地 Kyoto (JP).
- (72) 発明者: 早 川 海 斗 茂 (HAYAKAWA Atomo); 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地 T O W A 株式会社内 Kyoto (JP). 渡 辺 創 (WATANABE Hajime); 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地 T O W A 株式会社内 Kyoto (JP). 吉 岡 翔 (YOSHIOKA Sho); 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町

5 番地 T O W A 株式会社内 Kyoto (JP). 坂上雄哉(SAKAUE Yuya); 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地 T O W A 株式会社内 Kyoto (JP). 細見 隆也(HOSOMI Takaya); 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地 T O W A 株式会社内 Kyoto (JP).

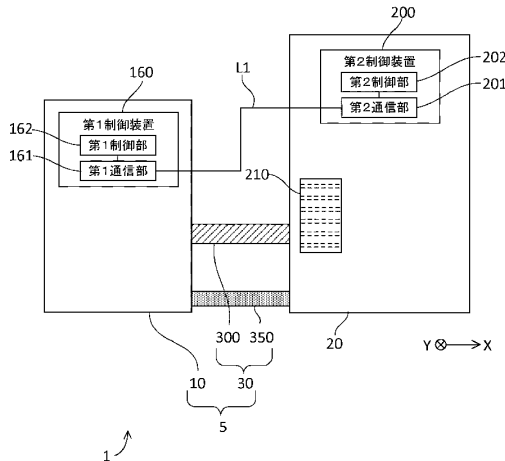
(74) 代理人: 藤 原 賢 司, 外 (FUJIWARA Satoshi et al.); 〒5300047 大阪府大阪市北区西天満 5 - 1 - 1 5 西天満パークビル 2 号館 4 階 Osaka (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST,

(54) Title: WARP CORRECTION SYSTEM, AND PRODUCTION SYSTEM

(54) 発明の名称: 反り矯正システム、及び、製造システム

FIG.1



- 160 First control device
161 First communication unit
162 First control unit
200 Second control device
201 Second communication unit
202 Second control unit

(57) Abstract: This warp correction system comprises a warp correction device and a relay unit. The warp correction device corrects warp in a first molded substrate and produces a second molded substrate. The relay unit is disposed between the warp correction device and a machining device on the exterior of the warp correction device. The machining device machines the second molded substrate. The relay unit includes a first conveyance mechanism that receives the second molded substrate from the warp correction device and conveys the second molded substrate to the machining device.

(57) 要約: 反り矯正システムは、反り矯正装置と、中継部とを備える。反り矯正装置は、第 1 成形済基板の反りを矯正し、第 2 成形済基板を製造する。中継部は、反り矯正装置の外部の加工装置と反り矯正装置との間に配置される。加工装置は、第 2 成形済基板の加工を行なう。中継部は、第 2 成形済基板を反り矯正装置から受け取り、加工装置へ第 2 成形済基板を搬送する第 1 搬送機構を含む。

[続葉有]

SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))